

이 보고서는 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해 발간한 보고서입니다.

기술분석보고서

 YouTube 요약 영상 보러가기

# 코스스(089890)

## 반도체

요약  
기업현황  
재무분석  
주요 변동사항 및 전망



작성기관

NICE평가정보(주)

작성자

송동근 전문연구원

- 본 보고서는 「코스닥 시장 활성화를 통한 자본시장 혁신방안」의 일환으로 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해, 한국거래소와 한국예탁결제원의 후원을 받아 한국IR협의회가 기술 신용평가기관에 발주하여 작성한 것입니다.
- 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 보고서의 요약영상은 유튜브로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미 게재 상태일 수 있습니다.
- 카카오톡에서 “한국IR협의회” 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.
- 본 보고서에 대한 자세한 문의는 작성기관(TEL.02-2124-6822)으로 연락주시기 바랍니다.

# 코세스(089890)

## 반도체 및 디스플레이 제조장비 전문기업

### 기업정보(2021/09/30 기준)

대표자	박명순
설립일자	1994/01/25
상장일자	2006/11/08
기업규모	중소기업
업종분류	반도체 제조용 기계 제조업
주요제품	반도체/디스플레이 제조장비

### 시세정보(2022/01/17 기준)

현재가(원)	12,950
액면가(원)	500
시가총액(억 원)	2,147
발행주식수	16,584,962
52주 최고가(원)	17,350
52주 최저가(원)	6,940
외국인지분율	0.43%
주요주주	박명순

### ■ 반도체 및 디스플레이 제조장비 전문기업

코세스(이하 동사)는 반도체 및 디스플레이 제조장비 전문기업으로, 주요제품은 솔더볼 부착장비, 레이저 가공장비 및 다양한 자동화 설비 등이 파악된다. 삼성전자, 에스케이하이닉스 등 반도체 전문기업을 매출처로 보유하고 있으며, 애플, BOE, CSOT 관계사 등에 제품을 납품하여 세계시장 내 인지도를 확보하고 있다.

### ■ 차세대 디스플레이 리페어 장비 상용화

Micro-LED, Mini-LED 등 차세대 디스플레이 제조공정에 활용되는 리페어 장비를 개발하여 상용화하였다. 차세대 디스플레이 제품은 하나의 패널에 수천만~수억 개의 소자가 적용돼 제품 양산 및 경제성 확보를 위해 리페어 장비 기술이 필수적이다. 일반적인 리페어 공정 중 불량소자를 레이저로 제거하고 새로운 소자를 솔더볼 등으로 결합하는 기술이 요구되며, 동사는 기존 솔더볼 부착장비 및 레이저 가공장비 분야에서 축적한 기술력을 기반으로 향후 추가적인 수주 확보가 가능할 것으로 전망된다.

### ■ ESG 도입 확대에 대비한 노력 필요

ESG는 기업의 지속 가능 경영을 위한 비재무적 요소로, 환경, 사회, 지배구조 부문으로 구성된다. 2021년 12월 산업통상자원부 K-ESG 가이드라인 발표, 대형 코스피 상장사들의 지속가능경영보고서 공시 의무화(2025년) 등 ESG의 중요성은 높아질 것으로 전망되며, 대기업부터 중소기업까지 점차적인 도입 확대로 산업 전반에 걸쳐 직간접적 영향이 예상된다. 이에, 동사 역시 환경정보 공개 및 전담부서 설치, 협력사 지원 프로그램 운영, 중장기 배당정책 수립 등의 대응책이 요구될 것으로 판단된다.

### 요약 투자지표 (K-IFRS 개별 기준)

구분 년	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2018	655	60.1	109	16.6	92	14.0	51.6	20.1	177.1	544	1,287	9.5	4.0
2019	656	0.1	77	11.7	62	9.5	25.9	11.1	99.3	371	1,661	23.6	5.3
2020	638	(2.7)	95	15.0	63	9.9	22.8	10.0	152.9	379	1,863	23.2	4.7

## 기업경쟁력

### 반도체 및 디스플레이 제조장비 전문기업

#### ■ 반도체 후공정 장비

- 솔더볼 부착장비, 다이 본더, 웨이퍼 절단 장비 등
- 반도체 기술 고도화에 따른 신공정 장비 개발

#### ■ 레이저 가공장비

- 반도체, 디스플레이, 전기전자 등 다양한 분야 적용
- 애플, 삼성 무선 이어폰 가공라인 등 납품

### 핵심경쟁력

#### ■ 보유 기술력 기반으로 신사업 진출

- 기존 사업에서 축적된 기술력 기반으로 차세대 디스플레이 리페어 장비 상용화
- 의료용 키트/화약 제조용 자동화장비 등 사업 다각화

#### ■ 국산화 개발 역량 보유

- 다이 본더 등 해외 수입 장비 국산화 개발

## 핵심기술 및 취급 품목

### 핵심기술

#### ■ 솔더볼 부착장비

- 솔더볼 공급부터 부착까지 전 공정 기술 보유

#### ■ 레이저 가공장비

- 우수한 정밀도 및 곡면 가공능력 보유

#### ■ 자동화장비

- 수행 공정, 특성 고려한 자동화장비 개발기술 보유

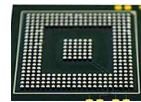
### 주력 제품



솔더볼 부착장비



레이저 가공장비



가공품 예시

## ESG 현황

### Environment

항목	현황
환경 정보 공개	<input type="checkbox"/>
환경 경영 조직 설치	<input type="checkbox"/>
환경 교육 수준	<input type="checkbox"/>
환경 성과 평가체계 구축	<input type="checkbox"/>
온실가스 배출	<input type="checkbox"/>
에너지, 용수 사용	<input type="checkbox"/>
신재생 에너지	<input type="checkbox"/>

☑ : 양호    ☒ : 미흡    ☐ : 확인불가

### Social

항목	현황
인권보호 정책 보유	<input type="checkbox"/>
여성/기간제 근로자 근무	<input checked="" type="checkbox"/>
협력사 지원 프로그램	<input type="checkbox"/>
공정거래/반부패 프로그램	<input type="checkbox"/>
소비자 안전 관련 인증	<input type="checkbox"/>
정보보호 안전 관련 인증	<input type="checkbox"/>
사회공헌 프로그램	<input type="checkbox"/>

☑ : 양호    ☒ : 미흡    ☐ : 확인불가

### Governance

항목	현황
주주의결권 행사 지원제도	<input checked="" type="checkbox"/>
중장기 배당정책 보유	<input checked="" type="checkbox"/>
이사회 내 사외이사 보유	<input checked="" type="checkbox"/>
대표.이사회 독립성	<input checked="" type="checkbox"/>
감사위원회 운영	<input checked="" type="checkbox"/>
감사 업무 교육 실시	<input checked="" type="checkbox"/>
지배구조 정보 공개	<input checked="" type="checkbox"/>

☑ : 양호    ☒ : 미흡    ☐ : 확인불가

- > 당사는 사업보고서 등 공식 자료에 환경 정보 공개, 환경 경영 조직 설치 관련 정보가 확인되지 않음.
- > 임직원 대부분이 기간의 정함이 없는 근로자로 구성되나, 산업 특성상 여성 근로자 비율이 낮음.
- > 전자투표제를 도입하였으며, 이사회 내 사외이사를 보유하고 있음.

\* 본 ESG현황은 NICE평가정보㈜가 분석대상 기업으로 입수한 정보를 요약 정리한 것으로, 분석 시점 및 기업의 참여도에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

## I. 기업현황

### 반도체 및 디스플레이 제조장비 전문기업

기존 반도체 후공정 장비 분야에서 축적된 노하우를 기반으로 레이저 가공장비 등으로 사업분야를 확장하였으며, 삼성전자, 에스케이하이닉스 등 반도체 전문기업과 애플, BOE, CSOT 등 글로벌 선도업체들의 관계사를 매출처로 보유하고 있다.

#### ■ 개요 및 사업 현황

동사는 1994년 1월 법인 설립되어 2006년 11월 코스닥시장에 상장된 중소기업이다. 경기도 부천시에 본사를 두고 있으며, 2021년 3분기 보고서 기준 최대주주는 지분율 49.31%의 박명순 대표이사로 파악된다.

#### ■ 보유기술 및 주요제품 현황

칩과 기판을 연결하는 솔더볼(Solder Ball) 부착장비와 레이저 가공장비 개발 역량을 기반으로, 반도체 및 디스플레이 제조에 사용되는 패키징 장비, 리페어 장비, 마킹 장비 등을 생산 중이다. 또한, 주요사업에서 축적된 기술 역량을 기반으로 화약/의료용 키트 제조용 자동화장비 등 다양한 산업영역에 진출하였다.

#### ■ 연구개발 활동

동사는 핵심기술 및 주요제품 관련 기술개발을 위하여 한국산업기술진흥협회로부터 공인된 기업부설연구소를 2007년부터 운영 중이며, 개발성과를 특허 등 지식재산권으로 보호하고 있다. 2021년 3분기 보고서 기준 특허 35건, 상표권 1건 등 등록실적이 파악된다.

표 1. 최근 보유 지식재산권

구분	발명의 명칭	등록번호	등록일
특허	미리 정해진 패턴으로 분포된 다수의 수용부에 솔더볼을 안착시키는 솔더볼 처리 장치	KR 10-2082792	2020.02.24
특허	미리 정해진 패턴의 수용부에 솔더볼을 안착시키는 솔더볼 처리 방법 및 이에 사용되는 솔더볼 스위퍼 장치	KR 10-2116994	2020.05.25
특허	라우팅 공정이 행해진 단위 기판을 이송하여 세워진 상태로 정렬시키는 기판 정렬 이송 시스템 및 이에 사용되는 기판 스탠딩 정렬 장치	KR 10-2190908	2020.10.22
특허	반도체 디바이스의 제조장치	KR 10-2174080	2020.10.29

\*출처: 특허정보넷(2021), NICE평가정보(주) 재구성

■ 주요 고객사

주요 매출처를 살펴보면 삼성전자, 에스케이하이닉스, 앰코테크놀로지코리아, 제이셋스태츠칩팩코리아를 비롯한 다국적 반도체 전문업체들이 파악되며, 애플, BOE, CSOT 등 글로벌 선도업체들의 관계사에 제품을 납품하는 등 세계시장 내 인지도를 높이고 있다.

■ 시장 현황 및 특성

동사 주요제품을 고려하여 반도체 후공정 패키징 장비, 국내 레이저 가공기 및 세계 레이저 가공 시장 전반을 살펴보고자 한다.

반도체 후공정 패키징은 반도체 소자 제조 후 전기적 연결, 밀봉 포장 및 조립 전반을 포함한다. 중소기업 기술로드맵(2021) 자료에 따르면, 세계 반도체 후공정 패키징 장비 시장은 2018년 3,520백만 달러에서 2024년 5,695백만 달러로 연평균 8.4%의 성장률을 보일 것으로 전망된다.

표 2. 세계 반도체 후공정 패키징 장비 시장 (단위: 백만 달러)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
조립 및 패키징 장비	3,360	3,640	3,940	4,250	4,590	4,940	5,340
본딩 장비	160	180	210	230	260	310	355
합계	3,520	3,820	4,150	4,480	4,850	5,250	5,695

\*출처: 중소기업 기술로드맵(2021), NICE평가정보(주) 재구성

국내 시장 규모는 2018년 4,300억 원에서 연평균 8.4% 성장하여 2024년 6,985억 원 규모가 될 것으로 예상되며, 2024년 기준 조립 및 패키징 장비 6,500억 원, 본딩 장비 485억 원으로 전망된다.

표 3. 국내 반도체 후공정 패키징 장비 시장 (단위: 억 원)

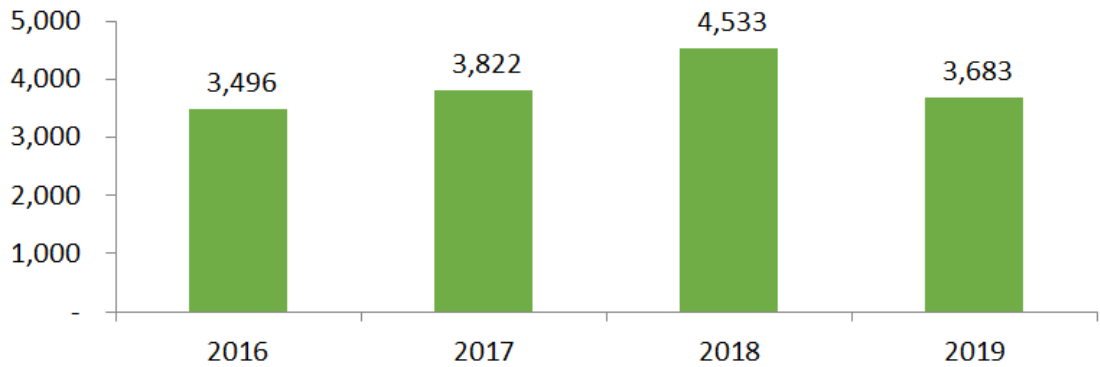
구분	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
조립 및 패키징 장비	4,075	4,415	4,780	5,210	5,640	6,000	6,500
본딩 장비	225	255	290	330	375	425	485
합계	4,300	4,670	5,070	5,540	6,015	6,425	6,985

\*출처: 중소기업 기술로드맵(2021), NICE평가정보(주) 재구성

반도체 제품 소형화 및 회로 집적화, 시간당 전달 신호 증가 등에 따라 고도의 정밀성을 보유한 패키징 장비가 요구되고 있으며, 향후 고가의 고성능 제품들이 시장 성장을 선도할 것으로 전망된다.

통계청 광업/제조업 조사(2021)에 따르면 국내 레이저 가공장비 시장은 2016년 3,496억 원 규모에서 2018년 4,533억 원 규모로 성장하였으나, 이후 역성장하여 2019년에는 3,683억 원 규모를 형성한 것으로 파악된다.

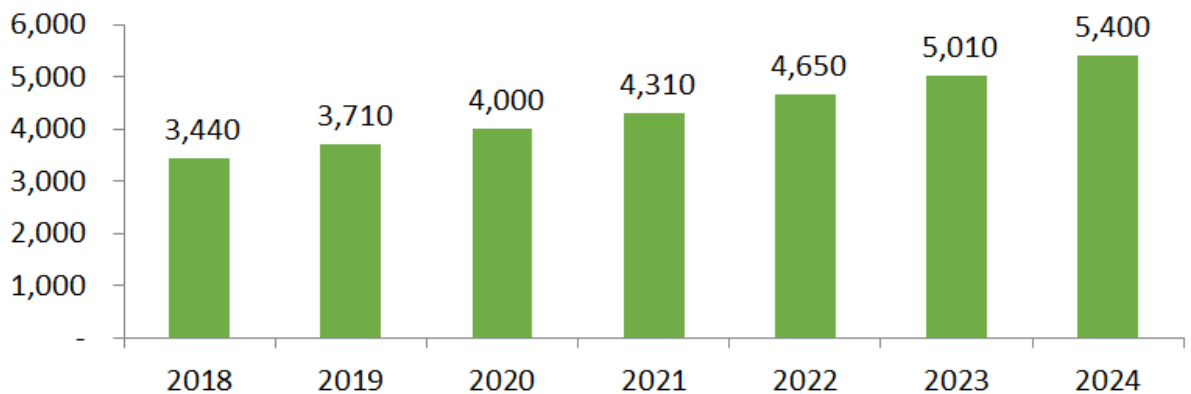
**그림 1. 국내 레이저 가공장비 시장** (단위: 억 원)



\*출처: 통계청 광업·제조업 조사(2021), NICE평가정보(주) 재구성

한편, 중소기업 기술로드맵(2021) 자료에 따른 세계 레이저 가공 시장은 2018년 3,440백만 달러에서 2024년 5,400백만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 2020년 대륙별 비중을 살펴보면 아시아태평양(APAC) 52.5%, 유럽 32.5%, 북미 22.5%, 기타 지역 10% 수준인 것으로 파악된다.

**그림 2. 세계 레이저 가공 시장** (단위: 백만 달러)



\*출처: 중소기업 기술로드맵(2021), NICE평가정보(주) 재구성

레이저 가공 산업은 초고속, 초정밀 가공을 기반으로 반도체, 디스플레이, 전기전자 등 사용처가 확대되고 있으며, 디스플레이 리페어, 미세패턴 형성, 복합형상 가공 등의 분야에서 주목받고 있다.



## II. 재무 분석

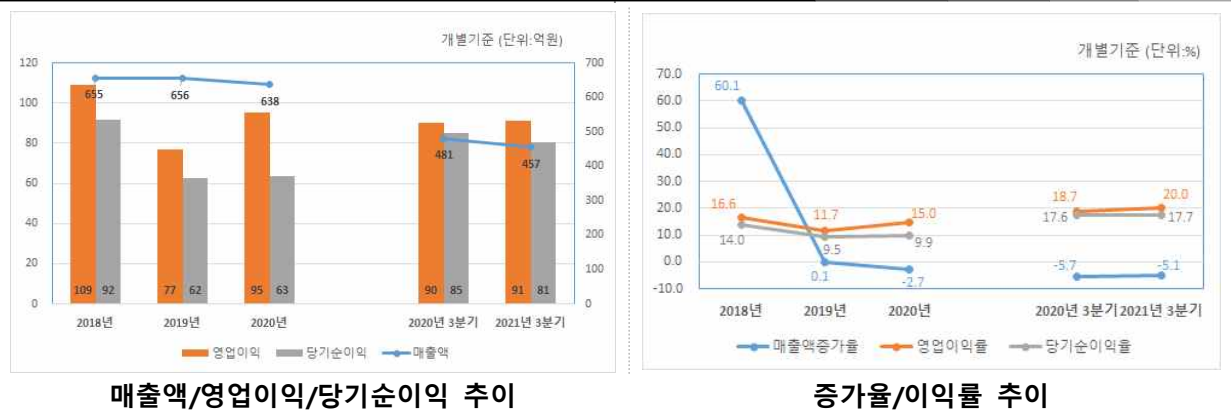
### 매출 정체 상태 나타낸 가운데, 수익구조 양호

동사는 반도체 장비 생산업체로, 2018년도까지 전방산업 호조에 따른 반도체 장비와 레이저 응용 장비의 수요 증가에 따라 높은 성장을 지속하다가 이 후 600억 원 규모로 정체 상태를 보이고 있다. 한편, 제품가 상승 및 원재료비 감소 등의 수혜 및 적절한 판관비 운용을 통해 양호한 수익성을 유지해 나가고 있는 가운데, 당기에는 매출채권 및 재고자산의 회전을 둔화로 외부 차입금이 크게 증가한 모습을 보였다.

#### ■ 안정적인 고객사 및 다양한 제품군 확보를 통한 매출 시현

동사의 매출 유형은 반도체 제조용 장비 부문, 레이저 응용 장비 부문, Conversion Kit, A/S 부문, 기타 임대수익 부문으로 구성되어 있으며, 2020년 개별기준 레이저 응용 장비 매출이 48.6%로 가장 높은 비중을 차지하고 있는 가운데, 전부문의 실적 증가에도 불구하고 반도체 제조용 장비 부문의 수요 감소로 전체 매출은 전년 대비 2.7% 감소한 638억 원의 매출을 시현하였다.

그림 3. 동사 연간 및 3분기 요약 포괄손익계산서 분석

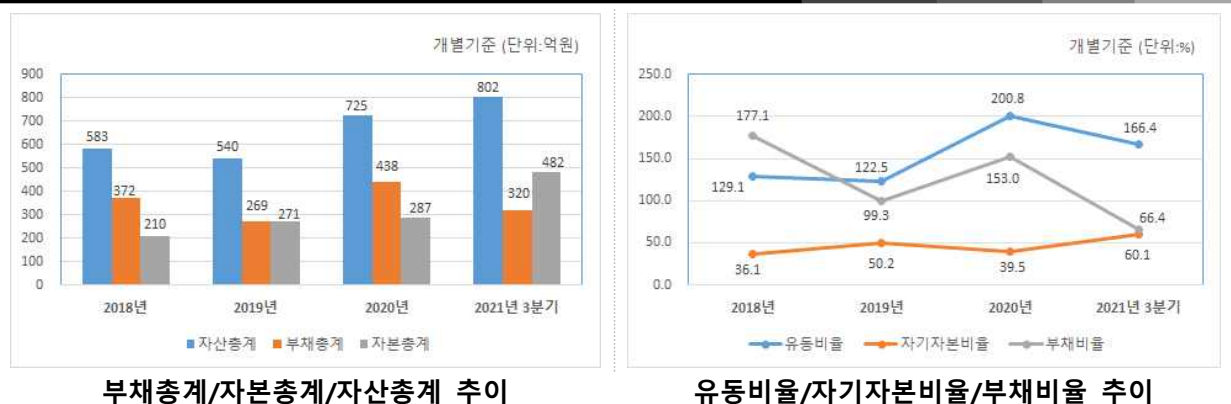


매출액/영업이익/당기순이익 추이

증가율/이익률 추이

\*출처: 동사 사업보고서(2020), 분기보고서(2021)

그림 4. 동사 연간 및 3분기 요약 재무상태표 분석



부채총계/자본총계/자산총계 추이

유동비율/자기자본비율/부채비율 추이

\*출처: 동사 사업보고서(2020), 분기보고서(2021)

■ 최근 3년간 양호한 수익성 유지

동사의 최근 3개년 매출 실적을 살펴보면 2018년 655억 원(+60.1% YoY), 2019년 656억 원(+0.1% YoY), 2020년 638억 원(-2.7% YoY)으로, 당기에는 코로나 19 등의 영향으로 인한 수출 감소로 전년 대비 실적이 소폭 감소한 모습을 보였다.

수익성 측면에서는 대손상각비, 경상개발비 등의 증가로 인한 판관비 부담의 확대에도 불구하고, 제조원가 부담의 완화로 영업 수익성이 전년대비 향상된 매출액영업이익률 15.0%를 기록하였고, 외환차손, 외환환산손실 등 금융비용의 증가 영향으로 매출액순이익률은 전년과 유사한 수준인 9.9%를 기록하여, 전반적으로 업계 대비 양호한 수익구조를 유지하고 있다.

■ 2021년 3분기 영업이익 향상, 2020년 말 재무 부담 확대

2021년 3분기 누적 매출액은 457억 원으로 레이저 응용 장비의 실적 저하로 전년 동기대비 5.1% 감소하였다.

수익성 측면에서는 인건비, 경상개발비 증가 등에 따른 판관비 부담의 확대에도 불구하고, 고부가가치 제품의 생산설비 프로세스 안정화 등 원가율 하락으로 전년 동기대비 향상된 매출액영업이익률 20.0%를 기록하였고, 외환차손, 대손상각비 등 금융비용의 증가 영향으로 매출액순이익률은 전년 동기과 유사한 수준인 17.7%를 기록한 바, 영업이익 91억 원을 시현하는 등 우수한 수익성을 나타냈다.

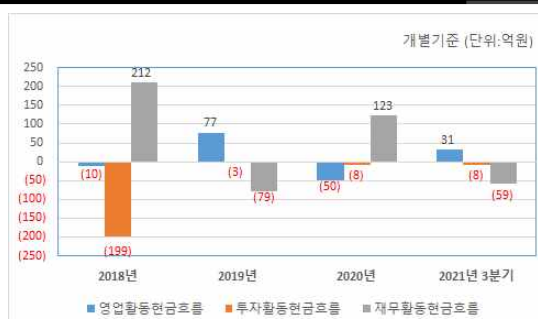
재무안정성 측면에서는 2020년 말 중화권 장비 공급에 따른 매출채권 및 재고자산 회전율이 둔화되면서 운전자금 부담이 확대되었고, 이로 인해 차입금이 크게 증가하여 재무안정성이 큰 폭 저하되었다. 한편, 2021년 3분기 기준으로는 자기주식 처분 및 이익 유보를 통한 자기자본 확충과 차입금 감소에 따른 부채 규모 축소로 자기자본비율 60.1%, 부채비율 66.4%, 차입금 의존도 20.2%를 기록하여 2020년 결산 대비 크게 개선된 모습을 보였다.

■ 매출채권과 재고자산의 동반 증가로 영업현금 (-) 전환

2020년 개별기준 양호한 순이익 시현에도 불구하고, 매출채권, 재고자산의 동반 증가로 인해 영업활동현금흐름이 -50억 원을 기록하는 등 부(-)의 상태로 전환되었다.

부족한 운전자금과 단기금융상품 취득 등 투자활동을 통해 유출된 자금 8억 원은 대부분 차입금 조달을 통해 충당한 바, 경직된 자금흐름을 나타낸 가운데, 잔여 자금은 내부 유보하여 기말 현금이 3억 원에서 67억 원으로 증가한 모습을 보였다.

그림 5. 동사 현금흐름의 변화



\*출처: 동사 사업보고서(2020), 분기보고서(2021)



### Ⅲ. 주요 변동사항 및 전망

#### 축적된 기술력 기반으로 전방산업 기술 고도화에 유연한 대응 가능

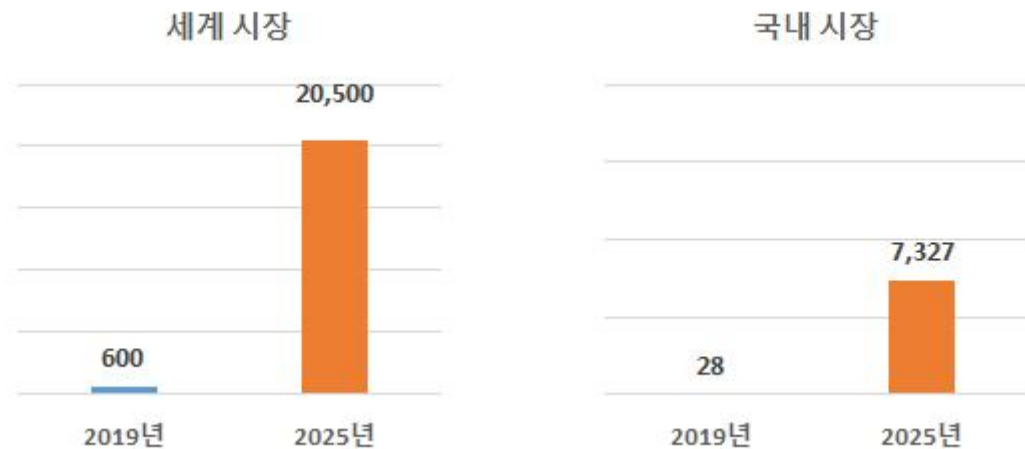
솔더볼 부착장비, 레이저 가공장비 분야에서 축적된 기술력을 기반으로 전자기기용 곡면 레이저 가공장비, 차세대 디스플레이 리페어 장비를 개발하여 상용화하는 등 전방산업 기술 고도화에 유연하게 대응하고 있다.

#### ■ 차세대 디스플레이 리페어 장비 상용화

차세대 디스플레이 생산공정에 적용 가능한 리페어 장비를 개발하여 상용화했다. 해당 장비는 중국 BOE 관계사 등에 납품된 바 있으며, 고객사들의 Mini-LED, Micro-LED 관련 설비투자에 힘입어 향후 매출 및 수익성 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

그림 6. Micro-LED 시장 전망

(단위: 백만 달러)



\*출처: 연구개발특구진흥재단 마이크로 LED 시장(2020), NICE평가정보(주) 재구성

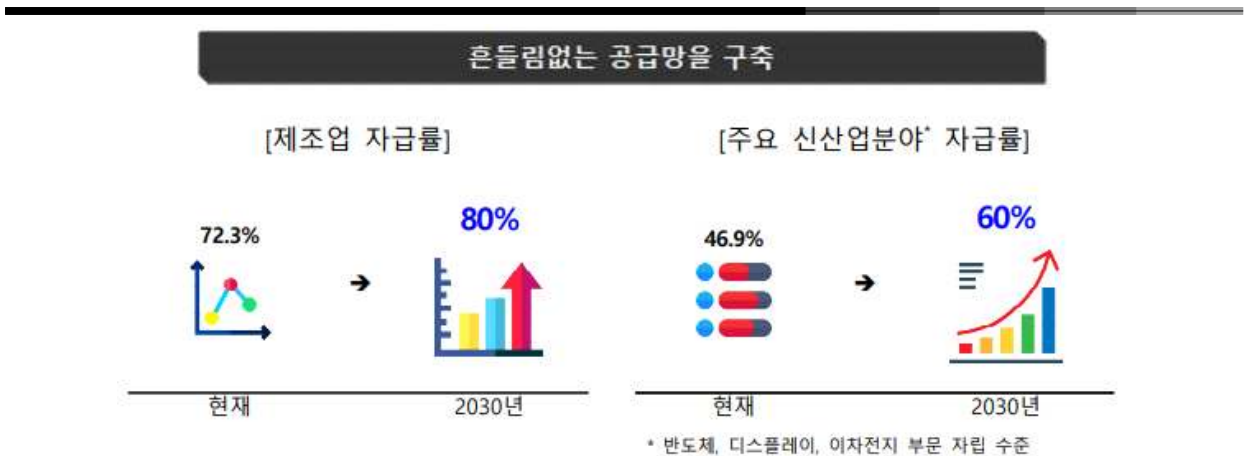
관련 분야 개발성과는 225 $\mu$ m 이하 초소형 불량소자를 기관 분리 후 새로운 소자를 결합하는 장비 특허 기술 등이 있으며, 이는 동사가 전문성을 보유한 솔더볼 부착장비, 레이저 가공장비 기술이 접목된 것으로 파악된다.

또한, 리페어 장비 외 의료용 진단키트(나노엔텍 등), 화약(한화 등) 제조 분야 스마트 팩토리 구축에 참여한 실적 등을 고려할 시, 동사는 기존 사업에서 축적된 기술력을 기반으로 신사업 진출 및 전방산업 기술 고도화에 유연하게 대응 가능한 것으로 판단된다.

## ■ 소재·부품·장비 분야 국산화 이슈

2019년 한일무역분쟁, COVID-19 사태에 따른 글로벌 공급망 교란, 2021년 중국발 요소수 공급 문제 등의 이슈가 불거짐에 따라 산업 전반에서 기술자립을 위한 노력이 시행되는 중이다. 특히 소재·부품·장비 분야의 국산화율 증대를 위하여 국가 차원의 정책 및 지원제도가 구축됐으며, 2020년 소·부·장 2.0 전략을 발표하여 글로벌시장을 선도하는 소·부·장 강국 도약, 첨단산업 투자유치 및 유턴을 통한 세계적 클러스터화, 범부처, 민관 총력 지원체계 지속 가동을 목표로 다양한 과제를 추진 중이다.

그림 7. 2030 소재·부품·장비 산업 목표



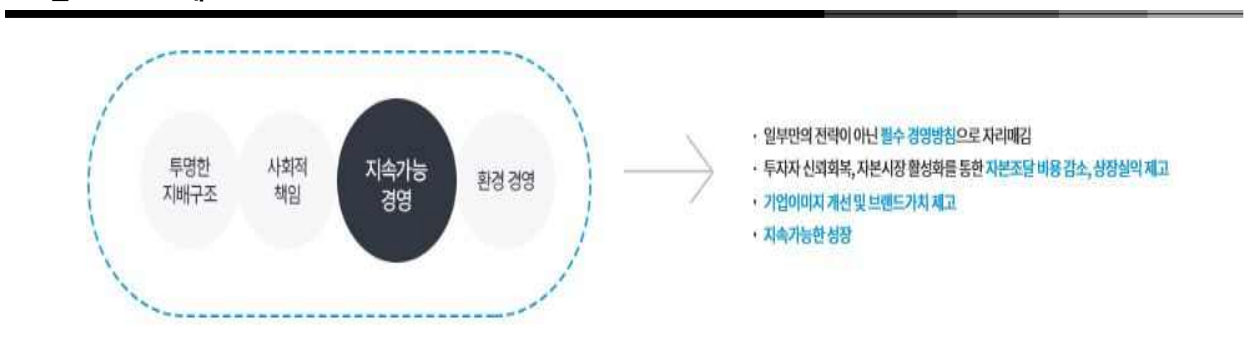
\*출처: 소재·부품·장비 2.0 전략(2020), NICE평가정보(주) 재구성

동사는 솔더볼 부착장비, 다이 본더 등 수입에 의존하던 제품들을 국산화 개발해왔으며, 향후 반도체 및 디스플레이 분야 기술자립을 위한 정책 및 지원제도에 긍정적 영향을 받을 수 있을 것으로 기대된다.

## ■ ESG 활동 현황

ESG는 기업의 비재무적 요소인 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 뜻한다. ESG 평가는 기업엔 지속 가능 경영의 동기를 유발하고 투자자에게는 사회적 책임투자에 대한 접근성을 제고하는 지표로 활용할 수 있다. 국내 ESG 평가를 수행하고 있는 기관은 한국기업지배구조원, 서스틴베스트, QESG 가 있다.

그림 8. ESG 개요



\*출처: 한국기업지배구조원 홈페이지(2021)

한국기업지배구조원(2021)은 ESG 평가등급을 공개하고 있으며, 각 등급은 S, A+, A, B+, B, C, D 7등급으로 구성되어 있다. 이 중 일부 반도체 및 디스플레이 제조장비 업체들의 ESG 평가등급은 다음과 같다.

**표 4. 한국기업지배구조원의 ESG 등급 현황**

기업명	기업코드	ESG 등급	환경	사회	지배구조	평가년도
이오테크닉스	039030	C	D	C	B	2021
에스에프에이	056190	B+	C	B	A	2021
한미반도체	042700	C	D	D	B	2021
참엔지니어링	009310	B	D	B	B+	2021

\*출처: 한국기업지배구조원(2021), NICE평가정보(주) 재구성

한편, 동사의 공개 자료를 통해 ESG 항목에 대한 사항을 별도로 확인하였다. 동사의 2021년 3분기 보고서에 따르면, 전체 근로자 196명 중 기간제 근로자 2명, 여성 근로자는 10명으로 확인된다.

**표 5. 여성/기간제 근로자 근무 현황**

사업 부문	성별	기간의 정함이 없는 근로자	기간제 근로자	합계
전체	남	185	1	186
	여	9	1	10
합계		194	2	196

\*출처: 3분기 보고서(2021), NICE평가정보(주) 재구성

지배구조 부문은 정관에 의해 주주의 의결권을 1주마다 1개로 정하고 있으며, 전자투표제를 도입하였고 대표이사 포함 3명의 이사 중 1명의 사외이사를 보유하고 있다. 이사는 주주총회에서 선임하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선정하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 함을 정함으로써 이사 선정의 독립성을 보장하고 있다.

미국, 유럽, 영국, 일본 등 선진국들을 중심으로 ESG 도입 분야가 확대되고 있으며, 국내 역시 2025년부터 자산 2조 원 이상 코스피 상장사의 지속가능경영보고서 공시를 의무화하는 등 움직임을 보이는 중이다. 또한, 산업통상자원부는 평가기관별 ESG 지표의 세부항목이 달라 같은 기업에 대해 등급 편차가 존재하여 평가대상인 기업의 혼란이 가중되고 있는바, 국내 상황에 적합한 K-ESG 가이드라인을 정의하여 2021년 12월 발표하였다.

ESG 도입 활성화에 따라 대형 업체들의 협력사 관리 등을 시작으로 산업 전반에 걸친 직간접적 영향이 예상되며, 향후 항목별 평가방식 구체화, 산업별 정량적 평가요소 도입을 대비한 노력이 요구될 것으로 판단된다.

■ 증권사 투자의견

작성기관	투자의견	목표주가	작성일
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 최근 6개월 이내 발간 보고서 없음</li> </ul>			

■ 시장정보(주가 및 거래량)



\*출처: Kisvalue(2022.01)